

Verarbeitungsparameter Lötstopmmaske KM3.0

Lagerung:

Das Laminat muß vor Hitze, Staub und jeglichem UV-Licht geschützt gelagert werden. Beste

Lagerbedingungen sind ein Kühlschrank oder ein Keller (kühl und feucht). Bei Lagerung bei Raumtemperatur wird die Mindesthaltbarkeit unter Umständen auf unter 6 Monate verkürzt.

Aufbau:

3 teilig

Teil 1 (weiß) = Abfallfolie
Teil 2 (grün) = Lötstopmmaske
Teil 3 (transparent) = Mylar-Schutzfolie

Verarbeitung

Die Abfallfolie wird vor dem Laminieren auf der Abfallrolle aufgespannt und automatisch entfernt.

Die Lötstopmmaske (freigelegte Seite) wird auf das Kupfer aufgebracht. Sofern seit der letzten Verarbeitung einige Zeit vergangen ist, muß zunächst ca. 30 cm Vorlauf gefahren werden, um frische Maskenoberfläche (ohne Raumstaub) zur Verfügung zu haben. ACHTUNG, nach längeren Standzeiten auf dem Laminator kann u.U. die Abfallfolie auf der Lötstoppmaskenseite festkleben. Die Abfallfolie muß dann von Hand gelöst werden.

Nach dem Laminieren sollte eine Haltezeit von 10 Minuten eingehalten werden.

Die Mylar Schutzfolie schützt die Heizwalzen während des Laminiervorgangs. Sie wird erst nach der Bildübertragung (also vor dem Entwickeln) entfernt.

Verarbeitungsparameter

Das Laminat muß auf einen sauberen, staub- und fettfreien Leiterplattenträger aufgebracht werden. Die Laminatstärke 3.0 mil ist für Kupferdicken bis 35µm ausgelegt.

Folgende Parameter sind am Laminator RLM 419p einzustellen:

Temperatur: 110 ° Celsius

Druck: Stufe 4-6

Geschwindigkeit: 0,2-0,4

Belichtung:

Das Laminat wird auf dem BUNGARD/Hellas Belichtungsgerät 30 Sekunden belichtet (bei hochtransparenten Filmen). Auf BUNGARD/EXP 2000 Geräten beträgt die Belichtungszeit 10 Sekunden.

Entwicklung:

Der Lötstopplack muß auf Sprühentwickleranlagen (JET / SPLASH / SPLASH CENTER / DL 500) mit 45°C warmer Natriumcarbonatlösung (1%ig) entwickelt werden. Entwicklungszeit ca. 2 Minuten (je nach Frische des Entwicklers). Anschließend muß die Platte unter kräftigem, warmen Frischwasserstrahl ca. 1 Minute gründliche abgespült werden und dann unter Heißluft (Fön, Warmluftgebläse BUNGARD/AIR 2000) getrocknet werden.

Aushärtung:

Schließlich muß das Material zur entgültigen Aushärtung 1 Stunden unter BUNGARD/HELLAS UV-Licht (5 Minuten unter EXP 2000) belichtet werden oder unter Frischluftzufuhr 1 Stunde bei 85°C im Heißluftofen. Erst dann erreicht die Lötstopmmaske ihre volle Widerstandskraft. ACHTUNG: nach dem Aushärten ist die Lötstopmmaske spröde und läßt sich nicht mehr auf Tafelscheren schneiden (Abhilfe: eventuell Schneidkanten im Layout freistellen).

Copyright 10/2001

Bungard Elektronik GmbH & Co KG
Jürgen Bungard

www.bungard.de